

# ダメージTEGウェハ

## 問題

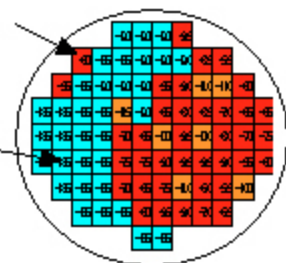
•エッチング、アッシング、イオン注入、**CVD**、スパッタ、洗浄など多くの半導体製造プロセスはデバイスの表面に電荷を残す可能性があり、それはトランジスタ特性そのものにダメージを与え、歩留まりや信頼性に大きな影響を及ぼす。

## 解

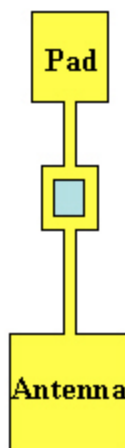
- ① フィルテックが任意の製造プロセスが及ぼすダメージを調査する為に設計されたテストウェハ(ダメージ**TEG**)を提供
- ② お客様が調査対象となっているプロセスで処理を施し、フィルテックに返送
- ③ フィルテックが電氣的にダメージを測定し、お客様に調査結果を報告。コンサルティング提供。

ダメージを受けたチップ

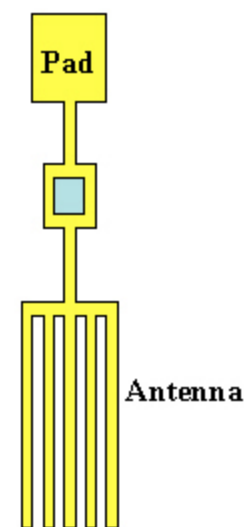
正常チップ



BOX



COMB



Antenna	Antenna Ratio					
BOX	2	100	1K	10K	100K	1M
COMB	2	50	500	5K	500K	2.5M

フィルテックが世界初で300mmダメージTEGサービスを開始。  
同一構造で200mmもサービス中。